



聯絡人

投資人關係

+886 3397 5999 ext. 18683 / 18684

ir@winfoundry.com

穩懋半導體公告 2023 年第四季自結財務報告

2024 年 2 月 5 日

穩懋半導體，全球最大砷化鎵晶圓代工服務公司，已於今(5)日公告 2023 年第四季自結財務報告。

2023 年第四季財務概況

- ◆ 本季合併營收新台幣 48.68 億元，較前季增加 17%，較去年同期增加 38%
- ◆ 本季合併毛利率為 29.4%，較前季增加 7.3 個百分點；
本季營業淨利率為 13.1%，較前季增加 11.4 個百分點
- ◆ 本季營業淨利為新台幣 6.39 億元，較前季增加 812%，較去年同期增加 2991%
- ◆ 本季歸屬於母公司淨利為新台幣 3.85 億元，前季為新台幣 3,400 萬元；
本季每股盈餘為新台幣 0.91 元，前季為新台幣 0.08 元

2024 年第一季度展望

下列對於未來展望的表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。請參閱後附之「免責聲明」。

- ◆ 第一季營收預計較前一季下滑 low-teens 百分比。
- ◆ 第一季毛利率預計約為 mid-twenties 的水準。

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。

管理者評論

“2023年第四季在安卓手機的庫存回補動能及全球高階智慧型手機新機發表後的需求持續挹注之下，合併營收略優於之前預期為新台幣 48.7 億元，較前一季及去年同期分別成長 17% 及 38%。綜觀第四季產品組合變化，如同之前的看法，除了Wi-Fi 客戶主要備貨期已過之外，其餘的產品皆有二位數成長，同時得力於產能利用率自上一季的50%上升到60%，使得第四季營業毛利率自上一季的 22.1% 上升到 29.4%，營業淨利率也自上一季的 1.7% 回升到 13.1%，單季EPS為新台幣0.91元。2023年全年合併營收為新台幣158.4億元，較2022年下滑了14%，累計全年EPS為新台幣-0.19元。

2023年在全球經濟低迷及地緣政治的風險中結束，回顧全年雖然疫情逐漸退散，但全球經濟始終壟罩在通膨的陰霾當中，加上區域衝突不斷，俄烏戰爭未完，以哈衝突再起，美中貿易更是日益壁壘分明，讓2023年成為辛苦的一年。所幸智慧型手機市場長達一年半的庫存調整期在2023年上半年進入尾聲，安卓手機庫存逐漸回歸到健康的水位，相關客戶也於下半年恢復拉貨動能，同時順應高階智慧型手機新機發表，Cellular 及3D感測客戶都進入拉貨期，使得下半年營收QoQ及YoY都開始轉為正成長，並重新回到獲利的道路。

進入新的一年，雖然外部大環境仍有許多雜音，但是我們可以肯定的說：產業谷底已然過去。穩懋長期投入於化合物半導體製程及材料，提供無線通訊、光通訊傳輸及光學感測解決方案，隨著未來AIoT大趨勢下巨量資料高速傳輸的需求將為我們帶來中長期的成長動能，首先，手機及基礎建設將受惠於更高的5G滲透率、手持式裝置及短距離基礎建設(包含IoT)將受惠於Wi-Fi 6E與Wi-Fi 7的演進引發更多PA需求，再者，VCSEL等光感測收發元件則將受惠於AI資料中心內部傳輸光進銅退的轉變、長短距離LiDAR未來將在車用ADAS成為主流而大放異彩，最後，低軌衛星通訊科技的崛起將使眾多AI和大數據得以無縫接軌實現全面串聯。以上種種，穩懋都有客戶與我們共同合作、並肩同行。

時序進入傳統淡季，展望2024年第一季，營收預期將較前一季下滑low-teens百分比，毛利率約為mid-twenties的水準。”

關於穩懋半導體

穩懋半導體成立於 1999 年，位於林口華亞科技園區，是全球首座以六英吋晶圓生產砷化鎵微波積體電路(GaAs MMIC)的專業晶圓代工服務公司。穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備，客戶群除了全球射頻積體電路設計公司(RFIC Design Houses)外，並致力吸引與全球整合元件製造(IDM)大廠合作。在製程技術發展方面，穩懋以多元化及領先為原則，期能提供客戶最完整的服務。在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋目前提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術：異質接面雙極性電晶體(HBT)和應變式異質接面高遷移率電晶體(pHEMT)，二者均為最尖端的製程技術。在光通訊及 3D 感測領域中，穩懋更以 MMIC 生產技術為基礎，提供光電產品的開發與生產製造。